



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20080313000

2008 年 4 月 2 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎 (牧)

TI-Dallas LBC3S (SPWELL) プロセス MAX3243xx/TRS3243xx 製品追加のご案内

(関連版 PCN20071116001 2007 年 11 月 27 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☐ Site ☒ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Assembly	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	TI-Dallas LBC3S (SPWELL) プロセス MAX3243xx/TRS3243xx 製品追加 現行：TI-Dallas、TI-Houston、TI-Sherman (LBC3S:SPWELL) 変更後：TI-Dallas、TI-Houston、TI-Sherman (LBC3S:SPWELL)、 TI-Dallas (LBC3S:SPWELL)	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	2008 年 6 月下旬の出荷より予定しています。 (サンプルについては、2008 年 3 月下旬より予定しています。)	
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり
備考	—	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。
また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：弊社 HVAL-SLL (汎用リニアロジック) MAX3243xx/TRS3243xx製品について、現行TI-Dallas/Houston/Sherman/Sherman (LBC3S:SPWELL) にて製造いたしておりますが、これに加えTI-Dallas LBC3S/SPWELLプロセス製品を追加し認定いたしました。追加に伴うデータシート及び製品名の更新はなく現行製品と同様にご使用いただけます。TI-Dallasサイト LBC3S/SPWELLプロセスは、弊社の他SLL製品にて既に適用し量産を継続しているものになります。

変更内容	現行	変更後
製造サイト	TI-Dallas	TI-Dallas
		TI-Dallas (LBC3S/SPWELL)
	TI-Houston	TI-Houston
		TI-Sherman (LBC3S/SPWELL)

評価用サンプル/開始期日：	MAX3243CDBR	2008年 3月26日
	MAX3243CDWR	2008年 3月26日
	MAX3243CPWR	2008年 3月26日
	MAX3243IDBR	2008年 3月26日
	MAX3243IDWR	2008年 3月26日
	MAX3243IPWR	2008年 3月26日

理由：製品安定供給確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
MAX3243CDB	MAX3243CDWRG4	MAX3243IDBR	MAX3243IPWRG4	TRS3243IDBR
MAX3243CDBE4	MAX3243CPW	MAX3243IDBRE4	TRS3243CDB	TRS3243IDW
MAX3243CDBR	MAX3243CPWG4	MAX3243IDW	TRS3243CDBR	TRS3243IDWR
MAX3243CDBRE4	MAX3243CPWR	MAX3243IDWR	TRS3243CDW	TRS3243IPW
MAX3243CDBRG4	MAX3243CPWRE4	MAX3243IPW	TRS3243CDWR	TRS3243IPWR
MAX3243CDW	MAX3243CPWRG4	MAX3243IPWG4	TRS3243CPW	
MAX3243CDWG4	MAX3243IDB	MAX3243IPWR	TRS3243CPWR	
MAX3243CDWR	MAX3243IDBE4	MAX3243IPWRE4	TRS3243IDB	

信頼性試験

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	2006 年 7 月 12 日	終了	2006 年 9 月 11 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TRS3243CDB	Die Rev/Size(mils):	H / 139 x 84	
Wafer fab Site:	DFAB	Technology/ Process:	BiCMOS / LBC3S	
Metal 1-2:	TiW/AICu.5%	Passivation:	10KACN	
Assembly Site:	MLA	Package/ Pins:	DB / 28	
Mount compound:	HIT EN4088Z	Mold Compound:	LOC GR825-73B	
Wire Bond Method:	TS-0.95mils Au	L/F Composition/ Finish:	Cu / NiPdAu	
Flammability Rating:	UL 94 V0	Moisture Sensitivity Level:	L1-260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
** Life Test	150C,300 hrs		116/0	
ESD - HBM	2000 V		3/0	
ESD - HBM -HIGH	15000 V		3/0	
ESD - MM	150 V		3/0	
ESD - CDM	1000 V		3/0	
Latch-up	JESD78, Class II		6/0	
Electrical Char.	approved by product engineering		pass	
** Preconditioning Sequence: JEDEC Level 1/260C				